

Le groupe de réflexion européen pour la 6G lance la feuille de route vers un leadership dans le domaine des puces pour la G

Ce projet a débouché sur une feuille de route stratégique de haut niveau assortie de recommandations visant à aider l'Europe à jouer un rôle de premier plan dans le domaine des puces pour les infrastructures de connectivité numérique, l'un des principaux objectifs de la proposition de loi européenne sur les puces.

Aujourd'hui, le projet «Horizon 2020» a réuni des experts de premier plan et des décideurs des secteurs des télécommunications et de la microélectronique dans le cadre d'un atelier politique afin de présenter sa feuille de route stratégique pour la recherche et l'innovation (R &I-). La feuille de route définit des actions stratégiques dans trois domaines prioritaires: Calte &Store, Connect &Communicate et Sense &Power.

La transformation numérique de l'industrie crée une demande massive de composants numériques. Les communications, y compris les téléphones mobiles et les infrastructures de réseau, représentent environ 31 % de la demande mondiale de semi-conducteurs et cette tendance augmente. Le domaine des composants électroniques et des puces pour les télécommunications suscite un vif intérêt industriel et politique, en particulier dans les domaines où les données, la microélectronique et la connectivité se rencontrent. L'Europe occupe une position de premier plan sur le marché mondial des infrastructures de connectivité, tout en étant fortement dépendante des fournisseurs de puces extérieurs à l'Union européenne.

La loi sur les puces européennes fixe comme objectif que l'Europe atteigne 20 % de la part de marché mondiale de la production de puces en 2030, en mettant particulièrement l'accent sur la faible part de marché actuelle de 4 % dans le secteur des puces pour les télécommunications. Cette feuille de route repose sur une analyse approfondie de ce défi à la lumière des tendances stratégiques et des débouchés commerciaux potentiels dans les domaines de la connectivité et de la microélectronique futures. Les conclusions portent sur une série d'actions stratégiques clés à court, moyen et long terme visant à relever les défis et à saisir les opportunités dans les 3 domaines prioritaires.

Citons par exemple:

- développer des réserves de talents dans des domaines spécifiques;
- développement des écosystèmes avec les communautés d'utilisateurs;
- capacités de conception et de production dans des zones sélectionnées;
- actions à grande échelle en matière de R &I;

L'intégralité de la feuille de route est disponible sur le site web de la commission des transports publics.

Les conclusions et recommandations stratégiques serviront de base à la définition du programme de

travail et aux actions futures des réseaux et services intelligents (SNS) et des futures entreprises communes dans le domaine des puces pour la 6G.

Dans un premier temps, les associations sectorielles concernées des deux entreprises communes (6GIA et AENEAS) ont récemment signé un protocole d'accord (ajouter un lien vers le communiqué de presse) pour relever conjointement ces défis communs.

Contexte

Dans le but de renforcer la puissance européenne dans le domaine de la microélectronique et de la connectivité, l'UE a lancé des initiatives majeures au cours des derniers mois. La proposition de loi européenne sur les puces, adoptée par la Commission au début de l'année 2022, a pour objectif de renforcer la compétitivité et la résilience de l'Europe dans les technologies et applications de semi-conducteurs et de contribuer à la réalisation de la transition numérique et écologique.

En étroite collaboration entre la Commission, les États membres et les principaux acteurs de l'industrie européenne, un nouveau projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) sur la microélectronique a été proposé, couvrant les domaines des réseaux de communication, de la mobilité et de l'automatisation industrielle. En outre, 2 partenariats européens, prenant la forme d'entreprises communes Horizon Europe, ont été lancés en décembre 2021: l'entreprise commune «Technologies numériques clés» et l'entreprise commune «Réseaux et services intelligents». La proposition de loi sur les puces a considérablement élargi la portée et l'ambition de KDT, en renommant l'entreprise commune KDT en entreprise commune Chips.

En savoir plus

- La réalisation du projet «nect»
- Loi européenne sur les puces
- Entreprise commune «Réseaux et services intelligents»
- Entreprise commune «Technologies numériques clés»

Thèmes associés

Connectivité Technologies numériques avancées Electronics 5G/6G Entreprise commune «Réseaux et services intelligents»

Source URL:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/news/european-think-tank-corenect-launches-roadmap-towards-leadership-chips-6g>